

ORD 特別講演会のご案内

『日東電工における R&D 戦略とその展望』

「Flexible Technology Company」を企業ビジョンとし、高機能フィルムで、世界トップシェアを誇る日東電工様において全社の技術部門を率いておられる表氏が、「オープン・フェア・ベスト」を行動の原点に掲げる自社の事例を中心に、経済復興に苦悩する関西のものづくりに進言する。

- ☆ 先着 80名 会場の都合により満席となり次第締め切らせて頂きます。
- ☆ 日時 2010年11月5日(金)
開場 午後2:30 講演 午後3:00~4:45 懇親会 午後5:00~6:30
- ☆ 会場 <講演> マイドームおおさか 8F 第1.第2会議室
大阪市中央区本町橋2-5 TEL 06-6947-4321(代)
<懇親会> 同サロン室 8F
- ☆ 参加料 <講演会> ORD 会員:2,000円 一般:3,000円
<懇親会> ORD 会員及び一般:5,000円
- ☆ 講師 日東電工株式会社 執行役員 副 CTO 全社技術部門長

表 利彦 (おもて としひこ) 氏

主催：大阪府研究開発型企业振興会

表 利彦(おもて としひこ) 氏 略歴

- 1983年 千葉大学工学部卒業
- 1990年 千葉大学自然科学研究科 博士課程終了
- 1990年 日東電工入社
- 1995年 回路付きサスペンション事業推進部グループリーダー
- 1996年 回路材事業部 MRH グループ長
- 2001年 同技術統括部長
- 2002年 同事業部長
- 2006年 全社技術部門基幹技術センター長を経て、2009年より現職。

専 門

感光性材料、特に感光性ポリミド。

著 書

- “PHOTOSENSITIVE POLYIMIDES Fundamentals and Applications”
(共著, Technomic Publishing Company, Inc, 1995年)
- POLYIMIDES FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS”
(共著, Marcel Dekker, Inc, 1996年)
- 『図解 最先端半導体パッケージ技術のすべて半導体進技術研究会編』
(株式会社 工業調査会、2007年)
- 『フレキシブルプリント配線板の最新応用技術半導体進技術研究会編』
(共著, 株式会社シーエムシー出版 2009年)
- 『最先端高密度配線銅めっき技術とその応用技術』
(共著, 株式会社シーエムシー出版 2009年 11)



お問い合わせ

大阪府研究開発型企业振興会(ORD)事務局
奥野製薬工業(株)企画開発部内 (担当:佐藤)
〒538-004 大阪市鶴見区放出東1-10-25
TEL 06-6961-0886 FAX 06-6963-0740

URL <http://www.ord.gr.jp>

Mail info@ord.gr.jp

裏面が参加申込書となっております。

ORD 特別講演会参加申込書

日東電工株式会社 表 俊彦氏 が語る(

「日東電工における R&D 戦略とその展望」



お申込み先: ORD事務局

FAX:06-6963-0740

メールでの申し込み先: info@ord.gr.jp

〆切り:10月20日(水)

開催日

(講演会)2010年11月5日(金) 15:00~16:45(開場 14:30)

マイドームおおさか 8F 第1,第2会議室

(懇親会)2010年11月5日(金) 17:00~18:30

マイドームおおさか 8F サロン室

講演会	参加する	・	参加しない
懇親会	参加する	・	参加しない
企業名等			
所属団体	ORD その他()		
所在地	〒		
電話	F A X		
e-mail			
参加者名	役職	所属	

*本講演会への受付証等は発行いたしません。当日会場に直接お越し下さい。

*お申し込み後の欠席は、必ずご連絡をお願いします。

*講演会、懇親会への参加費は、当日受付にてお支払いください。

*当日の写真・ビデオ撮影及び録音は固くお断りいたします。

【個人情報の保護について】

お客様の同意がある場合及び行政機関等から法令等に基づく要請があった場合を除き、当該個人情報の第三者への提供または開示をいたしません。ご提供頂いた個人情報を正確に処理するように努めます。